

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 19 年 12 月 13 日 (2007.12.13)

【公開番号】特開 2002-141377 (P2002-141377A)  
 【公開日】平成 14 年 5 月 17 日 (2002.5.17)  
 【出願番号】特願 2000-335003 (P2000-335003)  
 【国際特許分類】

**H 0 1 L 21/60 (2006.01)**  
**G 0 1 T 1/20 (2006.01)**  
**H 0 4 N 5/32 (2006.01)**  
**H 0 1 L 31/09 (2006.01)**

【F I】

H 0 1 L 21/60 3 1 1 W  
 H 0 1 L 21/60 3 1 1 R  
 G 0 1 T 1/20 E  
 G 0 1 T 1/20 G  
 H 0 4 N 5/32  
 H 0 1 L 31/00 A

【手続補正書】  
 【提出日】平成 19 年 10 月 23 日 (2007.10.23)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】明細書  
 【補正対象項目名】特許請求の範囲  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【特許請求の範囲】

【請求項 1】可撓性のベースフィルムと、前記可撓性のベースフィルムに配置された複数の配線と、前記配線に接続された IC チップと、を有する T A B テープであって、前記 IC チップは複数個配置され、前記 IC チップと前記配線との接続部における接続ピッチよりも前記ベースフィルムの少なくとも一方に配置された前記配線のアウターリード部のピッチが小さいことを特徴とする T A B テープ。

【請求項 2】前記複数の IC チップは、前記ベースフィルム内で互いに上下、左右方向でずれて配置されていることを特徴とする請求項 1 に記載の T A B テープ。

【請求項 3】前記複数の IC チップは同一回路構成であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の T A B テープ。

【請求項 4】前記ベースフィルムのアウターリード部から前記 IC チップまでの距離に応じて当該フィルム上の配線の配線幅が異なることを特徴とする請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載の T A B テープ。

【請求項 5】前記複数の IC チップは、前記アウターリード部側から見て互いに重なるように配置されていることを特徴とする請求項 1 に記載の T A B テープ。

【請求項 6】前記複数の IC チップの幅の合計よりも前記アウターリード部の幅が小さいことを特徴とする請求項 1 に記載の T A B テープ。

【請求項 7】センサー基板と、請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の T A B テープを複数有することを特徴とする放射線撮像装置。

【手続補正 2】  
 【補正対象書類名】明細書  
 【補正対象項目名】0 0 1 1  
 【補正方法】変更

## 【補正の内容】

【 0 0 1 1 】

## 【課題を解決するための手段】

本発明の目的は、可撓性のベースフィルムと、前記可撓性のベースフィルムに配置された複数の配線と、前記配線に接続されたＩＣチップと、を有するＴＡＢテープであって、前記ＩＣチップは複数個配置され、前記ＩＣチップと前記配線との接続部における接続ピッチよりも前記ベースフィルムの少なくとも一方に配置された前記配線のアウターリード部のピッチが小さいことを特徴とするＴＡＢテープによって達成される。